

IHスポットリフロー装置 N-TKG

簡易型卓上実験装置シングルヘッド仕様

<<非耐熱材料、3DMID上でのはんだ付けを可能にします。>>

■特徴

- IH（電磁誘導の原理）で金属部分のみを加熱します。（多段階加熱が可能）
- FPCB接合用、部品接合用 どちらかのヘッドを装備（発注時選択可能）
- 非耐熱材料上でのはんだ付けを可能にします。PET, PBT, 布, 3D MID 等
ACF 代替 圧を加える必要無し
レーザー代替 はんだ飛散、急激な温度上昇無し
手はんだの自動化
- 省エネ、省スペースを実現 ● 通常のはんだを使用可能
- 3D形状、カーブ面上でのはんだ付けも可能
- はんだ以外の 熱硬化型樹脂 等への適用も可能です。



FPCB接合用ヘッド



部品接合用ヘッド

■アプリケーション

- 樹脂製タッチパネル ● RF-ID
- 3D-MID ● ウェアラブル
- LCDバックライト (Soldering LED) ● リワーク

■実装例

- FPCBの樹脂製タッチパネルとの接合
3D,局面にも対応
- PET,布,紙上でのLED等部品はんだ付け
- 3D MID



本体外形	W650 x D650 x H750mm
本体重量	30Kg テラ含まず
加熱範囲	W4 x L50mm / W10 x L25mm
誘導加熱電源	2.8kw / 3.5kw
ヘッド仕様	任意選択（FPC用/電子部品用）
ワークサイズ （参考）	FPCB : 50 x 50mm 電子部品 : 1005チップ
加熱可能回路 （参考）	□形状 : Min. □ 0.5mm 回路幅 : Min. W=0.3mm
加熱方法	10段階式 ステップキュア

■多段階加熱:ステップキュア 温度プロファイル

